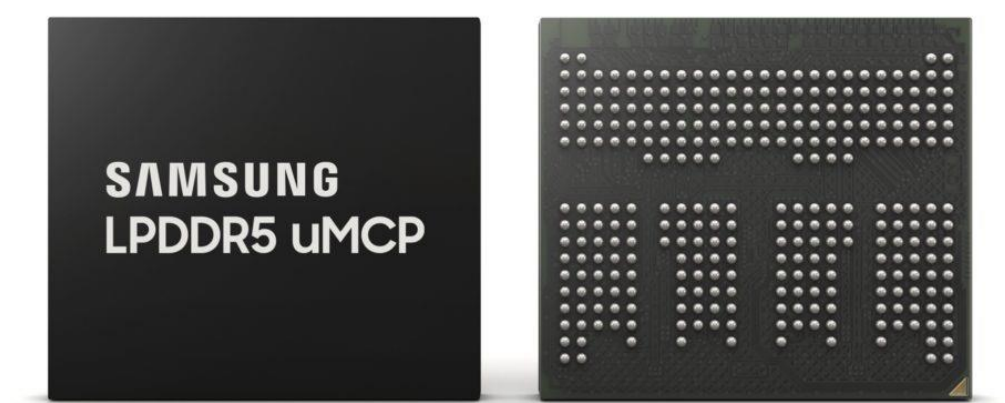


三星推出 LPDDR5 多晶片封裝解決方案 延伸旗艦規格至廣大智慧型手機市場

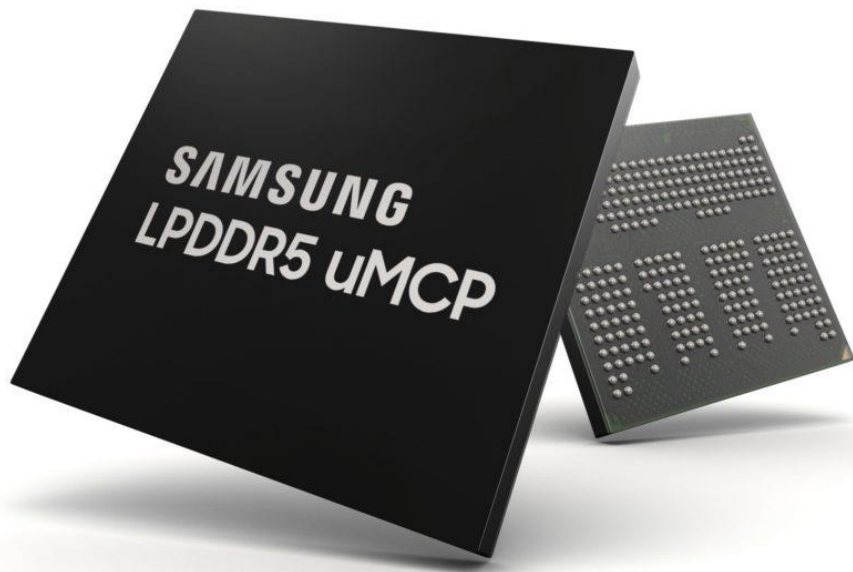
業界首創 LPDDR5 uMCP 本月量產 廣泛支援中高階智慧型手機

三星最新 uMCP 結合 LPDDR5 與 UFS 3.1 NAND 記憶體容量與效能表現領先
群倫 為更多手機用戶提供 5G 強大功能



全球先進記憶體技術領導品牌三星電子宣布，應用於智慧型手機記憶體的 LPDDR5 UFS 多晶片封裝解決方案 (uMCP) 已進入量產階段。該解決方案整合高速的 LPDDR5 DRAM 與最新 UFS 3.1 NAND Flash 快閃記憶體；為廣大智慧型手機用戶提供旗艦級效能體驗。

三星電子記憶體產品規劃團隊副總裁 Young-soo Sohn 表示：「三星透過長年深耕記憶體先進技術與封裝工藝，研發全新 LPDDR5 uMCP 解決方案；供非使用高階機款的用戶，亦可享受不中斷的串流、遊戲與混合實境體驗。5G 智慧型手機漸為主流；三星預期新一代多晶片封裝創新，將推動市場加速轉換至 5G 及發展新技術，同時將虛擬空間 (Metaverse) 進一步落實至日常生活中。」



全新 uMCP 解決方案以三星最新行動 DRAM 與 NAND 介面為基礎打造，可於極低功耗下提供快如閃電的速度與龐大儲存容量。透過該創新整合，廣大用戶將可體驗豐富的 5G 應用，包括進階攝影、圖像密集型遊戲與擴增實境（AR）等，且不再侷限於頂級旗艦機種。相較前一代 LPDDR4X UFS 2.2 解決方案，新一代方案的 DRAM 效能從 17 GB/s 提升至 25GB/s，增加近 50%；NAND Flash 快閃記憶體效能亦從 1.5GB/s 倍增至 3GB/s，完美支援旗艦級功能。

此外，全新解決方案將 DRAM 與 NAND Flash 快閃記憶體整合至 11.5mm x 13mm 的精巧封裝；為其他功能保留更多空間，進而有效提升智慧型手機硬體的空間效率。憑藉 6GB 至 12GB DRAM 容量，以及 128GB 至 512GB 的儲存選項；三星 uMCP 解決方案可輕鬆客製，滿足中高階 5G 手機市場的多元需求。

三星 LPDDR5 uMCP 解決方案已通過全球多家手機製造商的相容性測試，預計搭載 uMCP 的裝置將陸續於本月上市。

